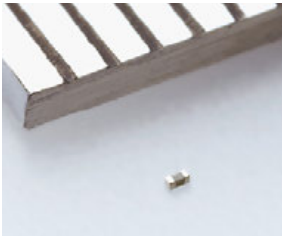
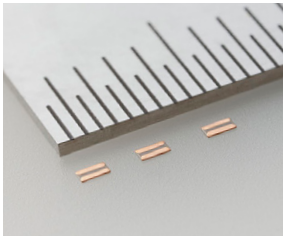
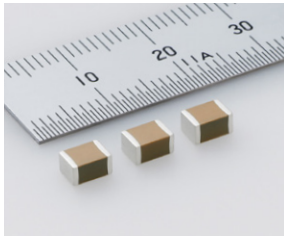
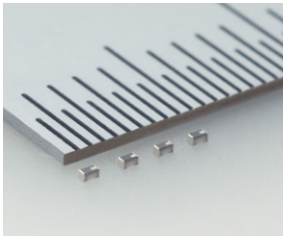
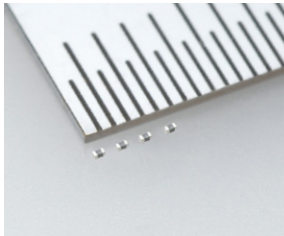
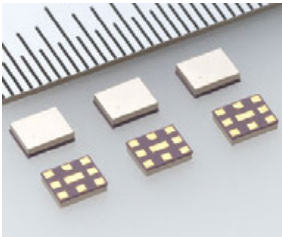
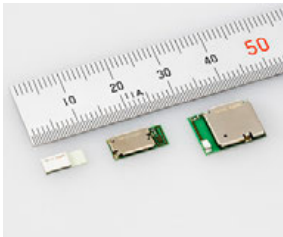
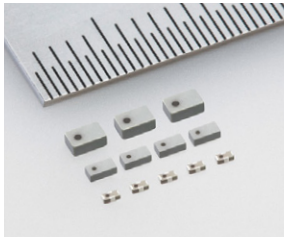


主力商品	売上高構成比 (2019年3月期)			売上高の推移 (単位:億円)	営業概況
コンデンサ 積層セラミックコンデンサ    超小型積層セラミックコンデンサ 0201サイズ(0.25mm×0.125mm) 超低背積層セラミックコンデンサ (0.6mm×1.0mm) 薄さ0.064mm 小型大容量積層セラミックコンデンサ 4532サイズ(4.5mm×3.2mm) 1,000μF 62% 1,176 1,428 1,706 201720182019 小型、薄型、大容量、高信頼性の積層セラミックコンデンサの開発に注力しています。誘電体の材料技術、薄層・大容量化技術および超小型品生産技術等を高度化することにより、最先端の積層セラミックコンデンサを開発し続けています。 2019年3月期の業績は、すべての機器向けの売上が前期と比べ増加したことにより、売上高は19.4%増の1,706億33百万円となりました。					
フェライト及び応用製品 - 巻線インダクタ - 積層チップインダクタなどの各種インダクタ商品    メタル系パワーインダクタ 「MCOIL™(エムコイル)」 高周波積層High-Qチップ インダクタ 超小型積層チップインダクタ 15% 412 409 405 201720182019 小型、薄型、大電流対応のインダクタに加え、自動車・情報インフラをターゲットとした大型、高信頼性のインダクタの開発に取り組んでいます。材料開発、巻線・積層プロセス技術を高度化させることで、競争力ある商品を開発しています。 2019年3月期の業績は、民生機器向け、自動車向けの売上が前期比で増加し、情報機器向け、通信機器向けなどの売上が前期比で減少したことにより、売上高は0.9%減の405億95百万円となりました。					
複合デバイス - モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW) - 電源モジュール - 高周波モジュール - 部品内蔵配線板「EOMIN™(イオミン)」    モバイル通信用デバイス (FBAR/SAW) 無線デバイス 積層セラミックフィルタ 17% 655 568 479 201720182019 モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW)の技術を高めた新商品の開発、5G(第5世代移動通信システム)に向けた次世代商品の開発、注力市場に向けて当社のコア技術を融合したソリューション型商品の開発に注力しています。 2019年3月期の業績は、モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW)や電源モジュール等の売上が前期に比べ減少したことにより、売上高は15.7%減の479億30百万円となりました。					
その他 - アルミニウム電解コンデンサ - エネルギーデバイス   アルミニウム電解コンデンサ リチウムイオンキャパシタ 6% 61 34 151 201720182019 注力市場へ向けてエネルギーデバイスの商品開発に注力しています。 2019年3月期の業績は、連結子会社化したエルナー株式会社のアルミニウム電解コンデンサなどが第2四半期から加わり、前期比341.2%増の151億89百万円となりました。					